

粉末スパッタリング受託成膜サービス

従来、スパッタリング成膜は主に基板(平面)を対象に行われていますが、近年はLiイオン電池や燃料電池などの分野において、粉末基材に対しあらゆる材料を担持(活性化)させる技術が求められています。

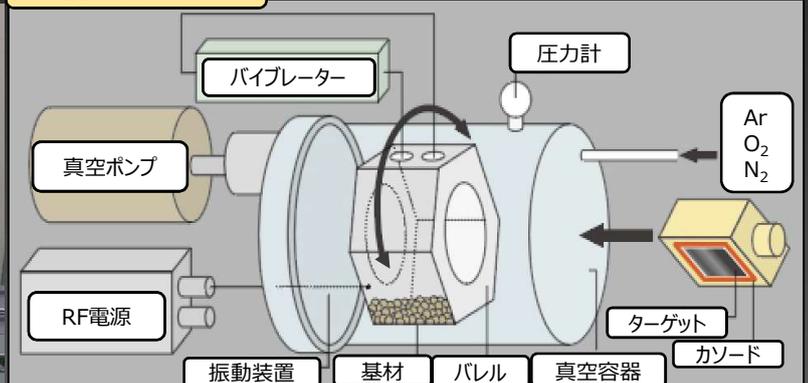
弊社では富山大学(阿部先生)との共同研究を経て、研究者の皆様からのご要望にお応えするため、スパッタリングターゲットメーカーという強みを最大限に活かし、粉末スパッタリング装置での受託成膜を承っております。

<装置外観・内部イメージ>

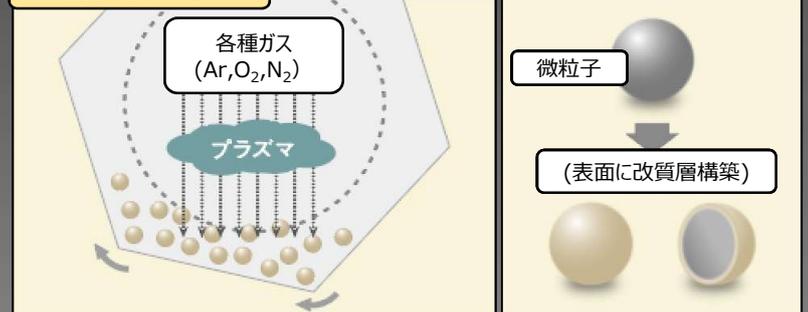
装置外観



構成イメージ



成膜イメージ



<ご参考事例>

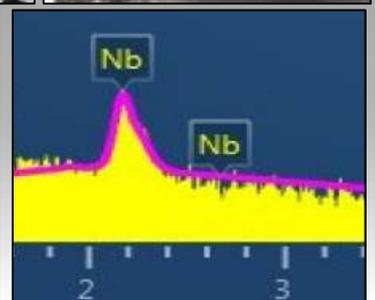
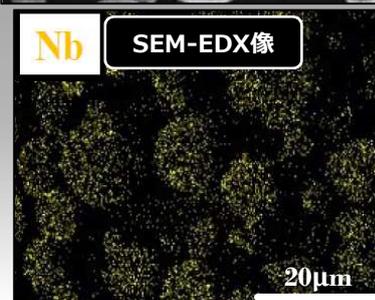
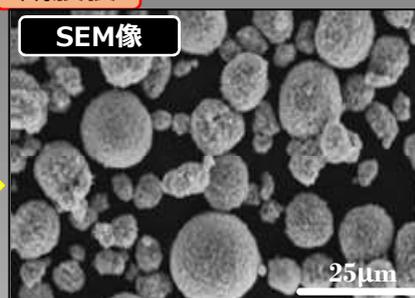
LiNi_{0.33}Co_{0.33}Mn_{0.33}O₂ (NCM111) 基材へのLiNbO₃成膜

成膜前



基材: LiNi_{0.33}Co_{0.33}Mn_{0.33}O₂ 粉末

成膜後



この他にも多数実績がございます。

是非お気軽にお問い合わせください。

TOSHIMA Manufacturing Co., Ltd.
Materials system division

株式会社 豊島製作所 マテリアルズシステム事業部
〒355-0036 埼玉県東松山市下野本1414
TEL: 0493-24-6774
URL: <http://www.material-sys.com>